

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
PUBLIC RELATIONS DIVISION
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio, 100-8310, Japan

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG Nr. 3186

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Kundenanfragen

Power Device Overseas Marketing Dept. A and Dept. B
Mitsubishi Electric Corporation

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/

Presseanfragen

Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation
prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp

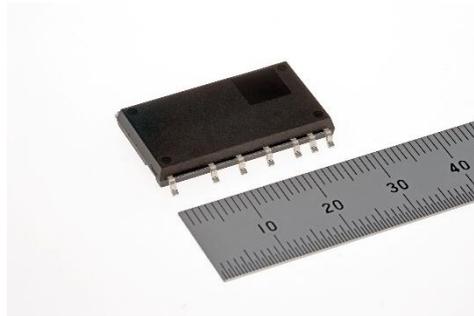
www.MitsubishiElectric.com/news/

**Mitsubishi Electric kündigt Produkteinführung von oberflächenmontiertem
MISOP-Paket-IPM an**

Damit werden kompaktere, einfachere und leichter zu installierende Wechselrichtersysteme ermöglicht

TOKIO, 16. April 2018 – [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.MitsubishiElectric.com) (TOKIO: 6503) kündigte heute die Produkteinführung eines oberflächenmontierten MISOP™-(Mitsubishi Electric Intelligent Small Outline Power Module-)Paket-IPMs (Intelligent Power Module, intelligentes Leistungsmodul) an, das die Implementierung kostengünstiger Wechselrichtersysteme dank seines kompakten und leicht lötbaren Paket-Designs ermöglicht. Dank seiner optimal angeordneten Anschlussbelegung, integrierten Treiber-ICs und Schutzschaltungen wird erwartet, dass das neue MISOP die Entwicklung von Wechselrichtersystemen mit kompakteren und einfacher konstruierten Leiterplatten (Printed Circuit Boards, PCBs) ermöglichen wird. Außerdem wird durch die Leiterplattenmontage mit Reflow-Löten eine einfachere und kostengünstigere Montage im Vergleich zu Produkten möglich, bei denen die Durchsteckmontage erforderlich ist. Das Produkt wird am 1. September eingeführt.

Das neue MISOP von Mitsubishi Electric wird auf wichtigen Fachmessen wie der MOTOR TECH JAPAN 2018 im Rahmen der TECHNO-FRONTIER 2018 in Makuhari, Japan, vom 18. bis zum 20. April, der PCIM Europe 2018 in Nürnberg, Deutschland, vom 5. bis zum 7. Juni und der PCIM Asia 2018 in Schanghai, China, vom 26. bis zum 28. Juni ausgestellt.



Oberflächenmontiertes MISOP-Paket-IPM

Im Einklang mit den zunehmenden globalen Umweltschutz- und Energiesparmaßnahmen werden Wechselrichtersysteme sogar in kleine Lüftermotoren, einschließlich Klima-Innen- und -Außengeräten, eingebaut. Das neue oberflächenmontierte MISOP-Paket-IPM von Mitsubishi Electric wurde speziell für Wechselrichtersysteme konzipiert, die Halbleitermodule mit geringem Stromverbrauch erfordern und einfach zu installieren sein müssen.

Produktmerkmale

1) Vereinfachtes Design für Wechselrichtersysteme

- Das oberflächenmontierte Paket-IPM ermöglicht Reflow-Löten.
- Nimmt nur wenig Platz auf der Leiterplatte in Anspruch.

2) Ermöglichung kompakterer und einfacherer Wechselrichtersysteme

- Der rückwärtsleitende IGBT (Leistungshalbleiter mit IGBT und Diode auf einem Chip) mit Dünnschichtstruktur der siebten Generation ermöglicht kompaktere IGBT-Chips und weniger Platzbedarf zwischen den Chips.
- Weniger externe Komponenten dank integrierten Gate-Treiber-ICs mit Schutzfunktionen und Bootstrap-Diode (BSD*) mit Strombegrenzungswiderstand erforderlich.
- Die optimierte Anschlussanordnung ermöglicht die einfache und unkomplizierte Konstruktion von Leiterplatten und die Entwicklung kompakterer Wechselrichtersysteme.

* Hochspannungsdioden, die in der Ladungspumpenschaltung verwendet werden, um die Mehrfachstromversorgung über eine einzige Spannungsquelle zu ermöglichen.

3) Schutzfunktionen für flexiblere Wechselrichtersystemdesigns

- Überhitzungsschutz und analoges Signal für die Überwachung der IC-Kontrolltemperatur.
- Kurzschlusschutz dank externem Nebenschlusswiderstand und PWM-Eingangssperrfunktion ermöglicht flexible Schutzschaltungsdesigns.

Zeitplan für den Verkauf

Produkt	Modell	Spannung	Strom	Auslieferung
Oberflächenmontierte MISOP-Serie	SP1SK	600 V	1 A	1. September
	SP3SK		3 A	

Hauptspezifikationen

Modell	SP1SK	SP3SK
Spannung	600 V	
Strom	1 A	3 A
Maße	15,2 × 27,4 × 3,3 mm	
Eingebaute Chips	Dreiphasige Wechselrichterbrücke mit eingebauten RC-IGBT-Chips (IGBT + FWD), HVIC-, LVIC- und BSD-Chips	
Integrierte Funktionen	<ul style="list-style-type: none">- Kurzschlusschutz dank externem Nebenschlusswiderstand- Niederspannungsschutz für Stromzufuhr- Schutz durch Fo-Ausgang auf N-Seite- Überhitzungsschutz- Analoger Temperaturspannungsausgang- Sperre	
Sonstiges	Wechselrichter mit geteilter Emitter-N-Seite (3 Nebenschlüsse)	
Anwendungen	Gebläsemotoren, Wasserpumpen und Spülmaschinen	

Umweltbewusstsein

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Produkte entsprechen den Vorgaben der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

###

Über die Mitsubishi Electric Corporation

Mit über 90 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger, hochwertiger Produkte ist die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ein anerkanntes, weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung, im Marketing und im Vertrieb von Elektro- und Elektronikgeräten für die Informationsverarbeitung, Kommunikation, Raumfahrtentwicklung und Satellitenkommunikation, Unterhaltungselektronik, Industrietechnik, den Energie- und Transportsektor sowie Gebäudeanlagen. Im Sinne seiner Unternehmensphilosophie „Changes for the Better“ und Umwelterklärung „Eco Changes“ setzt sich Mitsubishi Electric als globales, im Umweltschutz führendes Unternehmen dafür ein, die Gesellschaft mit neuen Technologien zu bereichern. Das Unternehmen verzeichnete konzernweit einen konsolidierten Umsatz von 4.238,6 Mrd. Yen (37,8 Mrd. US-Dollar*) im Geschäftsjahr zum 31. März 2017. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.MitsubishiElectric.com

* Zum Wechselkurs von 112 Yen für einen US-Dollar, der am 31. März 2017 von der Tokioter Devisenbörse angegeben wurde.

MISOP ist eine Marke der Mitsubishi Electric Corporation.